



VIEW A (SCALE:1:1)

△6	△4	178306-5
△6	△3	178306-3
△6	△2	178306-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

推奨基板取付け寸法  
 PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
 コネクタ: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
  - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
 : ニッケル下地の上に半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
 : ニッケル下地の上にスズめっき

				Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
				WIRE RANGE		INSULATION DIA	
				mm(AWG)		mm	
B1	REVISED ECR-07-013273	TS	DM	11 JUN 95		NAME 12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
B	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	S.M	6/2 '03		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
A	REVISED(FJD0-0114-03)	TS	SM	25 APR '03		10% ±0.3	SIZE LOC NUMBER
O	RELEASED FJ00-2528-95	NM	Y.I	6/30 '95		10% ±0.4	A3 J C-178306
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	DR. 23 JUN 95 N. Matsubara	30% ±0.45	SCALE REV. SHEET
					CHK. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA	角 度 : ±3'	2-1 B1 1 OF 1